

ASIGNATURA: Tecnología Electrónica PERIODO: Ing. Tec. Electrónica Industrial
TIPO DE PRUEBA: 2º Examen parcial FECHA: 9 de Junio de 2004

9. ¿Has entregado el trabajo correspondiente a los temas de circuitos integrados? En caso afirmativo escribe el título del mismo.

10. Explica breve y gráficamente en qué consiste la técnica de impresión de placas de circuito impreso (PCI) conocida como fotoinpresión directa.

1. Ventajas e inconvenientes del grabado de PCI con persulfato de amonio.

2. Explica brevemente el único método de taladrado de circuitos impresos que es compatible con la metalización electroquímica del mismo.

3. En un circuito impreso hay 14 componentes de inserción y 7 SMD, de los cuales uno es un Quad Flat Pack (ver figura). ¿En qué cara de la PCI los colocarías? ¿Cuántos procesos de soldadura habría que realizar en su fabricación?



4. Explica con un ejemplo cómo se asignan las referencias de esquema en un circuito esquemático cuando se trata de partes de componentes.

5. ¿Qué son las reglas de diseño de un circuito impreso?

6. Grabado de la PCI con percloruro férrico.

7. Diseño de circuitos impresos.



ASIGNATURA: Tecnología Electrónica TÍTULO: Ingeniero Tec. Electrónica Ind.
CONVOCATORIA: Septiembre FECHA: 09 de Septiembre de 2004

PRIMER PARCIAL

1. Explica razonadamente por qué las resistencias bobinadas no son recomendables para aplicaciones de alta frecuencia.

2. Describe breve y gráficamente el proceso de fabricación de los diodos de aleación.

3. Se desea fabricar un transistor de potencia capaz de conducir corrientes de AF de hasta 300A y bloquear tensiones de hasta 1.000V, ¿qué técnica(s) podrías escoger para que las elevadas corrientes de conducción no perjudique su comportamiento en frecuencia? Explica brevemente tus razones.

4. Características generales de los condensadores para uso en electrónica.

SEGUNDO PARCIAL

1. Ventajas e inconvenientes del grabado de PCIs con percloruro férrico.

2. En un circuito impreso hay 14 componentes de inserción y 7 SMD, de los cuales uno es un Quad Flat Pack (ver figura). ¿En qué cara de la PCI los colocarías? ¿Cuántos procesos de soldadura habría que realizar en su fabricación?



3. ¿Qué consideraciones se deben tener en cuenta a la hora de asignar referencias en un circuito esquemático?

4. Grabado de la PCI con persulfato de amonio.

APELLIDOS: Cabrerias Raskiguera NOMBRE: JASSÉ

Las preguntas 7 y 8 se puntuarán sobre 2 puntos, las demás se puntuarán sobre 1 punto

APELLIDOS: NOMBRE: La pregunta 4 y 8 (de desarrollo) obtendrá una puntuación doble que las demás (de síntesis).